

### 型号

### 技术规格

## I/O EXPRESS

### 分布式数字系统(DDS)



直接的热电阻和热电偶输入  
每个I/O模块最多21路通道  
每系统最多7812个点  
子站对子站系统和子站对主站系统  
主站模块/从站模块和无宿主模块

#### 主站模块

**扫描周期:** 每50 ~ 150毫秒对下接的12个从站模块扫描1次, 具体取决于从站模块的I/O组态

**隔离能力:** 500Vdc (输入、输出、电源间)

#### 模拟输入模块

**精度:** 量程的  $\pm 0.15\%$  (12位分辨率)

**扫描周期:** 每隔5毫秒对每个通道扫描1次

**隔离能力:** 500Vdc (通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线、电源及输入通道间)

**输入阻抗:** 250 (电流输入)或1M (电压输入)

#### 模拟输出模块

**精度:** 量程的  $\pm 0.15\%$

**扫描周期:** 每隔10毫秒对每个通道扫描1次

**隔离能力:** 500Vdc(通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线与输出通道间)

**驱动能力:** 700 (24V输入电源)

#### 热电阻输入模块

**精度:** 读数的  $\pm 0.25\%$

**分辨率:**  $\pm 0.1$

**扫描周期:** 每隔1.3秒对每个通道扫描1次

**隔离能力:** 500Vdc(通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线、电源及输入通道间)

#### 热电偶输入模块

**精度:**  $\pm 3$

**分辨率:** 0.5

**扫描周期:** 每隔5毫秒对每个通道扫描1次

**隔离能力:** 500Vdc(通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线、电源及输入通道间)

**输入阻抗:** 10M

**断偶保护:** 高限驱动

#### 数字输入模块

**扫描周期:** 每隔10毫秒对每个通道扫描1次  
**隔离能力:** 500Vdc(通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线电源与输出通道间)

**输入阻抗:** 3300

**最大输入电压:** 30Vdc

**阈值电压:**  $>7V$ 为高电平,  $<0.5V$ 为低电平。

#### 数字输出模块

**扫描周期:** 每隔10毫秒对每个通道扫描1次  
**隔离能力:** 500Vdc (通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线电源与输出通道间)

#### 继电器输出模块

**扫描周期:** 每隔10毫秒对每个通道扫描1次  
**隔离能力:** 500Vdc(通讯线间; 通讯线与电源间; 通讯线与输出通道间)

**触点参数:** 8通道模块的继电器为SPDT, 容量3A@24Vdc或110Vac; 12通道模块的继电器为常开SPST, 容量1A@24Vdc或0.5A@110Vac

#### 其它

**通信线传输距离:** 取决于通信线的规格、传输波特率及环境条件等。24 AWG 双绞线为1.6km (以19.2K波特传输时) 或3.2km (以4800波特传输时); 主站模块与从站模块间最大距离15m。

**波特率:** 2400、4800、9600、19.2K波特, 由用户组态

**数据刷新周期:** 取决于系统中模块个数、波特率、采用的通信线缆及系统的通信距离

**电源:** 11-30Vdc外部电源

**操作温度:** -5 ~ +65

**相对湿度:** 10 ~ 90%(无冷凝)

**环境温度对精度的影响:** 量程的  $\pm 0.015\%$  ~  $\pm 0.02\%$  (每1 )

**调校:** 通过内部跳线设置波特率和模块地址

**重量:** 580g

## 选型说明

型号	模块类型	输入/输出组态	电源	封装
DDS	<b>主站模块：</b> <b>MH</b> “子站对主站”中的主控模块 (每系统最多可配31个子站) <b>MP</b> “子站对子站”中的主控模块 (每系统最多可配8对共16个模块)	<b>子站对主站或子站对子站系统中的主站模块(MH和MP)：</b> <b>S12</b> 12路输入/输出通道,从/向12个从站模块接收/发送信号。	<b>10-30DC</b> <b>10-30Vdc</b>	<b>DIN</b> 塑壳封装，带可拆取接线块，装于标准Top-Hat轨道或DIN轨道
	<b>子站对主站系统中的从站模块和无宿主模块：</b> <b>S</b> 子站对主站系统中的从属模块 (每个MH主控模块最多可配12个，每个子站对主站系统最多可配372个)  <b>MLH</b> 子站对主站系统中的无宿主模块(每个系统最多可配31个)	<b>RT18</b> 8路热电阻输入通道 (3线，Pt100) <b>TJ110</b> 10路J型热电偶输入 <b>TK110</b> 10路K型热电偶输入 <b>AI12XX</b> 12路模拟输入通道(XX代之以20mA、2V、5V、10V时分别表示4-20mA、0-2V、0-5V、0-10V) <b>A0820MA</b> 8路4-20mA信号输出通道 <b>DI21</b> 21路数字输入通道(外部供电，11-30Vdc) <b>D021</b> 21路数字输出通道(集电极开路输出，200mA，40Vdc) <b>R08</b> 8路继电器输出通道 <b>R012</b> 12路继电器输出通道		
	<b>子站对子站系统中的从站模块和无宿模块：</b> <b>S</b> 子站对子站系统中的从站模块 (每个MP主站模块最多可配12个，每个子站对子站系统最多可配92个)  <b>MLP</b> 子站对子站系统中的无宿主模块(每个系统最多可配8对共16个)	<b>AI12XX</b> 12路模拟输入通道(XX代之以20mA、2V、5V、10V时分别表示4-20mA、0-2V、0-5V、0-10V) <b>A0820MA</b> 8路4-20mA信号输出通道 <b>DI21</b> 21路数字输入通道(外部供电，11-30Vdc) <b>D021</b> 21路数字输出通道(集电极开路输出200mA，40Vdc) <b>R08</b> 8路继电器输出通道 <b>R012</b> 12路继电器输出通道		

**选型格式：** 型号/模块类型/输入或输出组态/电源/[封装]

例：**DDS/MH/S12/11-30DC/[DIN]** (主站模块)

**DDS/S/AI1220MA/11-30DC/[DIN]** (从站模块)

**DDS/MLH/TJ110/11-30DC/[DIN]** (无宿主模块)